

本品可一次測定塑膠薄膜基材、軟包裝複合膜、塗布紙及其它熱封複合膜在一定熱封速度、熱封壓力和五種熱封溫度下的熱封參數。熱封材料的熔點、熱穩定性、流動性及厚度不同，會表現出不同的熱封性能，其封口工藝參數可能差別很大。使用該機可準確、高效地獲得最佳熱封性能參數。

特 徵

微電腦控制、液晶顯示
功能表式介面、PVC 操作面板
一次完成五組十件試驗
數字 P.I.D.溫度控制
六組熱封頭獨立控溫
下置式雙氣缸同步回路
手動與腳踏二種試驗啟動模式
防燙傷安全設計
微型印表機
RS232 介面

技術指標

熱封溫度：室溫~250℃
熱封壓力：0.05MPa~0.7MPa
熱封時間：0.1~999.9s
控溫精度：±0.2℃
溫度梯度：≤20℃
氣源壓力：0.05MPa~0.7MPa（氣源用戶自備）
氣源介面：Φ6mm 聚氨酯管
熱 封 面：40mm×10mm×5 塊
外形尺寸：526mm(L)×430mm(B)×450mm(H)
電 源：AC 220V 50Hz
淨 重：51kg

標 準

QB/T 2358（ZBY 28004）、ASTM F2029、YBB 00122003

配 置

標準配置：主機、腳踏開關、微型印表機
選購件：專業軟體、通信電纜

注：本機氣源介面系Φ6mm 聚氨酯管；氣源用戶自備。

